# **HIGH POWER TEST OF TTF-V INPUT COUPLERS**

Masato Sato<sup>1A)</sup>, Eiji.Kako<sup>A)</sup>, Yasuchika Yamamoto<sup>A)</sup>, Ken Watanabe<sup>A)</sup>, Shuichi Noguchi<sup>A)</sup>, Hassan Jenhani<sup>B)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, Japan, 305-0801

<sup>B)</sup>CEA-Saclay

91191, Gif-sur-Yvette cedex, France

#### Abstract

The TTF-V input couplers were originally designed at DESY and they were fabricated at LAL-Orsay. The conditioning of the couplers was carried out in collaboration with LAL-Orsay from February till May in 2009. In the initial stage, the conditioning was started in the pulsed operation with shorter pulse width of  $20 \mu$  s. And then, the power level and the pulse width were gradually increased up to 2 MW and 1.5 ms at 5 Hz. The vacuum pressure and the emitted electrons were carefully observed during the conditioning to avoid the fatal damage of the RF windows. In this report, we will report the conditioning result of the TTF-V couplers.

# TTF-V入力結合器の大電力試験

### 1. TTF-V入力結合器

ドイツのDESYでXFEL計画が進行中であり、 Lバンド超伝導加速空洞用に入力結合器TTFーⅢ カップラーが開発された。この入力結合器は同軸タ イプで結合度が可変であり、円筒セラミック窓を使 用していることが特徴である。XFELでは運転加 速勾配が23.5MV/m、ビーム電流値10mA であるのに対し、ILCでの運転仕様は31.5M V/m、10mAであり、単位長さ当たりのビーム 負荷がXFELの1.3倍となる。フランスのLA L (Linear Accelerator Laboratory)  $\forall T T F - II D \gamma$ プラーをILC用に改良を加えたものがTTF-V カップラーである。外導体直径を62mmに拡げ、 マルチパクタリング共鳴条件を大電力側にシフトさ せている。KEKではLバンド超伝導加速空洞の開 発試験を行うためにSTF (Superconducting RF Test Facility)が整備されており、この大電力高周波シス



 $\boxtimes 1$  : RF System

テムを用いてTTF-Vの大電力試験が行われた。

## 2. RF試験の機器構成

STFにおけるRF試験の構成を図1に示す。2 本のTTF-Vカップラーの低温部を結合導波管で 接続し、RF回路の上流からPi1、Pr1、Pi 2、Pr2の4台の方向結合器を設けることにより 通過及び反射電力をモニターする。また、大電力運 転時にはシステムの状況を確認するためにクライス トロン出力Pk1yをモニターした。真空度につい ては二台のカプラーの室温部と低温部のそれぞれを 共通に排気し、電離真空計Vac1、Vac2にて モニターをした。

他のセンサー類については図2に示すとおり熱電



 $\boxtimes 2$  : Sensor Position

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: masato.satoh@kek.jp

対(銅コンスタンタン)とエレクトロンプローブが 設けられている。カップラー1についてはT1~T 7とE1~E3、カップラー2についてはT11~ T17とE11~E13が割り当てられ、温度と放 出電子をモニターした。熱電対の具体的な取り付け 位置は室温側セラミック窓、室温側ベローズ、低温 側セラミック窓の各前後とアンテナポートのフラン ジ部である。このカップラーが超伝導空洞に実装さ れる際はアンテナ側が極低温状態に、また導波管側 が室温であるので、本稿では便宜的に"低温側" "室温側"という表現を用いる。

## 3. RF試験の経過

RF試験は2009年2月から2009年5月に かけて計三回実施され、ショートパルスからロング パルスへパルス幅を拡げて行き、投入電力も段階的 に上げて行った。この試験の目標は5Hzのパルス 運転において400µsのショートパルスで2MW、 1.5msのロングパルスで1MWの電力を投入す ることであり、最終的にこれらの条件による運転を 確立した。しかし、ショートパルス時のエージング が不十分であるために放電が発生した他、ロングパ ルス大電力では温度上昇と真空度悪化により長時間 運転は困難であった。以下に三回のRF試験につい て主な経過を述べる。



図3:1st RF Test

#### 3.1 第一回試験(2/6~2/10)

2/6~2/100第一回試験ではパルス幅を2 0 $\mu$ sのショートパルスに設定し、1MWまでの電力を投入した(図3)。図の横軸はRF電力を投入 した通算時間を示している。繰り返し周波数は原則 5Hzで行ったが、途中10時間目から20時間目 については安全且つ効率的なエージングを期待して 1Hzに変更している。この間はアークセンサーイ ンターロックによるシステムダウンが度々生じた他、 一定RF電力に対する真空度の改善が見られないこ とにより5Hz運転に再び戻された。20時間目以降は真空度のインターロックレベルを2E-4~5 E-4Paへと適宜変更し、真空度と電子放出量を



+Pin1





監視しながら投入電力を上げて行った。200kW まで既に約30時間のエージングを要しているが、 その後1MWまでは約10時間程度で到達した。

#### 3.2 第二回試験(3/9~3/27)

第二回試験は3/9~3/27に実施され(図 4)、この期間で目標とするショートパルスとロン グパルスの最大電力を投入する予定であった。パル ス幅20 $\mu$ s~200 $\mu$ sについては順調に2MW の電力投入できたが、パルス幅400 $\mu$ sで900 kWの電力を投入した時に一回目の放電が発生した。 放電音とともにアークセンサーと真空インターロッ クによりRFシステムがダウンした。通算時間で7

0時間目である。図中70時間目から真空度が急激 に低下しているのは、以降は断続的に真空悪化現象 が起こり、繰り返し周波数を1Hzに下げ、パルス 幅も10µsに変更したからである(90~120 時間目)。第二回試験時の電子放出量を図5に示し ており、E1プローブの挙動はVac1の変動によ く一致している。検出量の絶対値は異るがE13を 除く全てのプローブについてはE1と同様、周辺の 真空度の変動と相関が強い。これに対しカプラー2 のコールド窓低温側に位置するE13は図6に示す とおり、周辺のVac2との相関が弱い(ただし、 E13の符号は真空度と比較するために反転させて いる)。放電発生以降の1Hz、パルス幅10 μ s の低電力時にVac2は低下しているのに対し、E 13は一定して10V前後の出力が観察された。エ レクトロンプローブの出力電圧はプローブ周辺の電 磁場の影響を強く受け、各位置、運転状態により極 性が異なる。

120時間目以降は再び5Hzに戻され、パルス 幅と投入電力を段階的に上げ、通算時間の175時 間目で400 $\mu$ s、2MWに到達した。その後80 0 $\mu$ s、1300 $\mu$ sへパルス幅を伸ばしたがロン グパルスでは200kWの電力までエージングを確 認した。



 $\boxtimes 7$  : 3rd RF Test



#### 3.3 第三回試験(5/18~5/20)

第二回の試験が終了してから三回目RF試験ま での52日の休止期間中は6E-6Paの高真空 でシステムを保持している。第三回RF試験は5 /18~5/20、通算時間の190~206時 間に行い、特にロングパルスで1MWの運転を目 標とした。ここで199~206時間目の運転状 況を図7、また、その時の各所の温度変化を図8 に示す。前回二回の試験によるエージングが有効 であり、短時間で大電力を投入できている。この 期間では繰り返し周波数を1Hzと5Hzに切り 替えながらパルス幅を800µs、1.3ms、 1.5msへ伸ばして行き、最終的に目標値の1. 5ms、1MWに到達した。既に扇風機による強 制空冷は行っているが、投入電力に応じて温度上 昇と真空悪化が見られる。パルス幅1.3msと 1.5msで1MWを投入した際はセラミック窓 の破損を防ぐためにピーク電力を保持したのは5 分間に止めており、その5分の保持時間中も温度 上昇と真空悪化が見られる。温度上昇の最も大き いのは熱電対T15でカプラー2のセラミック窓 上端であり、最大56.5℃に達した。付近には 変則的挙動を示すE13があり、エレクトロン放 出との関連が考えられる。カプラー1の同じ位置 にあるT5は最大26.0℃に上昇しており、E 3の出力も低い。室温側導波管上部のT1とT 11については共に約36℃の温度上昇であった。

#### 4. 終わりに

STFでRF試験を終了して、現在TTF-V 入力結合器は分解梱包後にLALに返送された。 この分解作業中には二台共に室温側導波管接続部 に放電痕が確認されており、フランジ接続部の設 計変更が望まれる。その他、ヘリウムリーク試験 を行った結果は、室温側、低温側共にセラミック 窓からの真空リークはないことも確認できた。今 後はLALにおいて温度上昇と電子放出の大き かったカプラー2の低温側セラミック窓付近が分 解検査される予定である。

#### 謝辞

本研究は2008年度日仏共同研究(FJPPL)による資金援助によって行われた。

 $\boxtimes 8$ : Temperature in the 3rd RF test